

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和5年6月16日(2023.6.16)

【公開番号】特開2023-67951(P2023-67951A)

【公開日】令和5年5月16日(2023.5.16)

【年通号数】公開公報(特許)2023-089

【出願番号】特願2023-32122(P2023-32122)

【国際特許分類】

C 08 L 63/00(2006.01)

10

C 08 K 3/00(2018.01)

C 08 K 3/22(2006.01)

H 01 L 23/29(2006.01)

【F I】

C 08 L 63/00 C

C 08 K 3/00

C 08 K 3/22

H 01 L 23/30 R

【手続補正書】

20

【提出日】令和5年6月8日(2023.6.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

エポキシ樹脂と、硬化剤と、無機充填材とを含有し、

30

前記無機充填材の粒度分布が、少なくとも3つのピークを有し、

前記無機充填材が、粒子径が1μm以下のアルミナを含み、

前記無機充填材の粒度分布が、40μm～70μmの範囲にピークを有し、

前記無機充填材に占めるアルミナの割合が、60質量%～90質量%である封止組成物。

【請求項2】

前記無機充填材の粒度分布が、0.3μm～0.7μmの範囲、7μm～20μmの範囲及び40μm～70μmの範囲にピークを有する請求項1に記載の封止組成物。

【請求項3】

前記無機充填材に含まれる粒子径が1μm以下の無機粒子に占めるアルミナの割合が、1体積%～40体積%である請求項1又は請求項2に記載の封止組成物。

【請求項4】

前記無機充填材の平均円形度が、0.80以上である請求項1～請求項3のいずれか1項に記載の封止組成物。

【請求項5】

半導体素子と、前記半導体素子を封止してなる請求項1～請求項4のいずれか1項に記載の封止組成物の硬化物と、を含む半導体装置。

40

50